

Elenco dei materiali richiesti in fornitura:

a) 3 circuiti stampati multistrato codice "Test GBTX V2", così descritti:

spessore del circuito 1,6mm

dimensioni circuito: 105 x 121.5mm

4 layers, 2 solder, 2 serigrafie, doratura chimica su tutto il circuito entrambi i lati

Dimensione piste: 6 mils

Isolamento minimo: 6 mils

Foro minimo: 0.4 mm

b) 3 circuiti stampati multistrato codice "Icarus Power Monitor V2", così descritti:

Spessore del circuito stampato 2.4 mm

dimensioni del circuito 80x283mm (costituito da due figure distanziate di 3mm)

4 layers, 2 serigrafia, 2 solder mask,

Spessore minimo pista 0,1mm ed isolamento 0,2mm

Foro minimo 0.4 mm

c) 4 circuiti stampati multistrato codice "ICA_Test_FE_8ch_v2"

spessore del circuito 1,6mm

dimensioni circuito: 262x140mm (costituito da due figure distanziate di 3mm)

4 layers, 2 solder, 2 serigrafie, doratura chimica

Dimensione piste: 0,2mm e Isolamento minimo: 0,2mm

Foro minimo: 0.4 mm

d) 6 circuiti stampati doppia faccia codice "ICA_Power_Supply_V3"

circuito stampato **spessore 2,4 mm** avente le seguenti caratteristiche:

dimensioni: 160x100 mm, **spessore rame 70 micron**

Solder Mask: 2 (top e bottom) Serigrafia: 2 (top e bottom)

Spessore minimo piste 0,2mm e Isolamento minimo 0,2mm

Diametro foro min: 0.6 mm

e) 6 circuiti stampati doppia faccia codice "ICA_Power_Supply_Light"

circuito stampato **spessore 2,4 mm** avente le seguenti caratteristiche:

dimensioni: 80x100 mm, **spessore rame 70 micron**

Solder Mask: 2 (top e bottom) Serigrafia: 2 (top e bottom)

Spessore minimo piste 0,2mm e Isolamento minimo 0,2mm

Diametro foro min: 0.6 mm

f) 3 circuiti stampati doppia faccia codice "ICA_LED's Board"

circuito stampato **spessore 2,4 mm** avente le seguenti caratteristiche:

dimensioni: 80x65 mm, **spessore rame 70 micron**

Solder Mask: 2 (top e bottom) Serigrafia: 2 (top e bottom)

Spessore minimo piste 0,2mm e Isolamento minimo 0,2mm

Diametro foro min: 0.6 mm

Il Responsabile del Procedimento
(Marino Nicoletto)

